

Контрактное производство электроники

Наше производство — ваш успех!



SMD-монтаж на двух линиях поверхностного монтажа

- Монтаж чип компонентов от 0,4 x 0,2 мм
- Монтаж микросхем QFN, BGA с минимальным шагом 0,3 мм
- Минимальный размер платы 50 x 50 мм
- Изготовление опытных образцов и крупносерийное производство

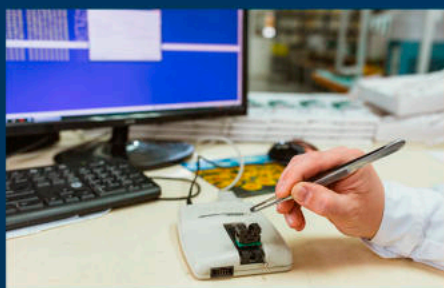


THT-монтаж

- Пайка волной и ручным способом
- Установка радиаторов и трансформаторов
- Отмычка в ультразвуковой ванне
- Влагозащита

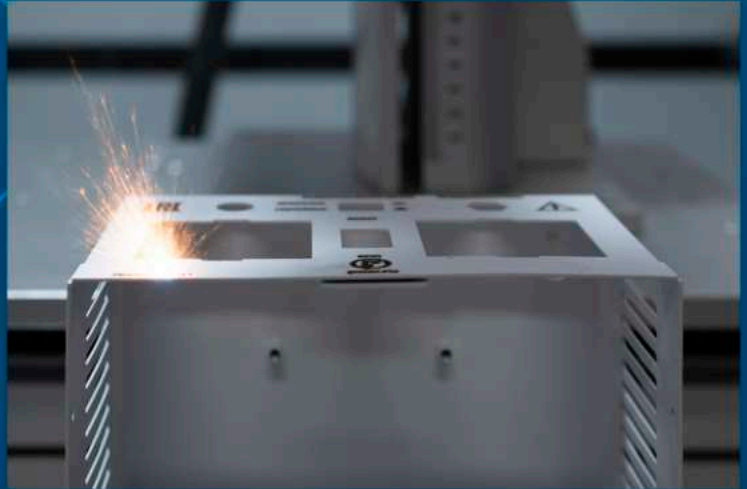
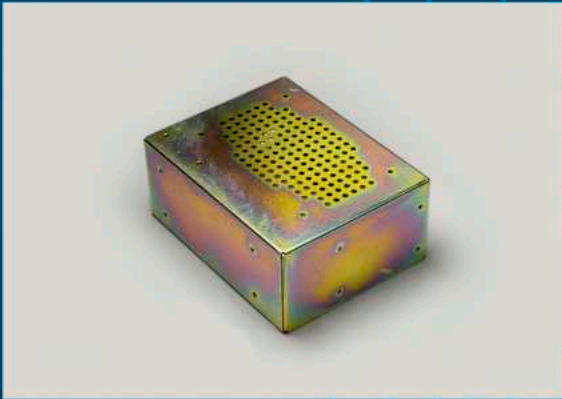
Программирование и испытание контроллеров, микросхем, готовых изделий

- Программирование
- Функциональное тестирование
- Финальная сборка



Изготовление корпусов, доработка покупных корпусов РЭА

- Материал корпусов – сталь, алюминий
- Гальваническое покрытие – цинк, оксидирование, анодирование
- Запрессовка шпилек, втулок
- Порошковое покрытие готовых корпусов
- Лазерная и ультрафиолетовая маркировка



Изготовление жгутов, кабельных сборок по спецификации заказчика, распайка разъёмов

- Автоматизированная нарезка и зачистка провода
- Обжимка наконечников
- Протяжка провода в изоляционные материалы – ПМЛ, трубка ТУТ, гофротрубка
- Бандажирование, заливка разъёмов компаундами, маркировка
- Проверка на соответствие электрической схеме

